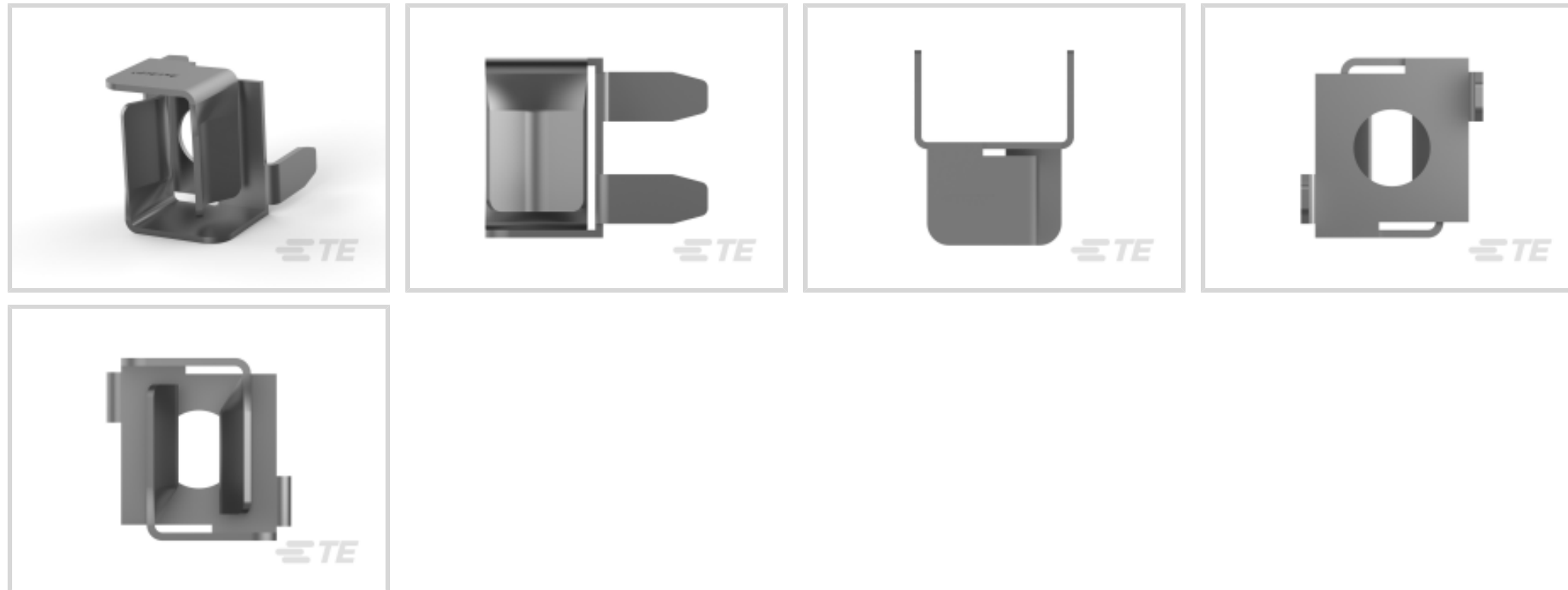


端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 母端

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

端子电镀材料: 锡

封装方法: Reel

带导线绝缘: 不带

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm [100 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	5.08 μm [200 μin]
PCB 端子类型	母端
端子电镀材料	锡
端子方向	标志

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	2500
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 <p>TE 产品编号1775284-3 HPI, 2.5MM, EMIX, A'SSY, V/T, 3P, IVORY</p>	 <p>TE 产品编号1623722-4 SBCH 11 33R 5%</p>	 <p>TE 产品编号5415633-1 RTANG BNC PCB JACK - 75 OHM</p>	 <p>TE 产品编号2-1393203-8 V23148-A1007-A101</p>
 <p>TE 产品编号1-1542001-2 HTS264NF-D=HS ASSY PPA CLIP</p>	 <p>TE 产品编号1825013-6 MRD10CSTR04=7MM ROT DIP, BCD COMP</p>		

文档



CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_63566-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_63566-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_63566-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本